

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 19 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：向平先生 独立董事：郑鹏程先生 副总经理兼财务总监：龚静女士 董事会秘书：黄然先生 保荐代表人：罗妍女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、活动具体内容： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，与投资者就公司业绩、发展情况以及其他投资者关心的问题进行沟通，交流方式以文字问答方式进行。公司与投资者交流的主要内容如下： 二、提问及回复： 1、公司的 Wi-Fi 产品研发进展如何？是否已出货？ 答：尊敬的投资者，您好。公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在中高低端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。公司针

对宽带高速短距无线通信场景所研发的 Wi-Fi6 2T2R 无线局域网芯片，采用自研 RF 系统架构，最高可支持 80MHz 带宽及 1024QAM 调制方式，发送和接收速率最高可达 1.2 Gbps。此款芯片在片内集成了 5GHz 和 2.4GHz 频段的 RF Transeiver、PA、LNA 以及 Wi-Fi6 的基带、MAC 和 USB/PCIE/SDIO 等高速接口，具备高集成度特点；芯片采用 QFN68(8mm×8mm)封装形式，实现业界同类型芯片的最小尺寸的封装。公司 Wi-Fi6 2T2R 无线局域网芯片在国内同行业产品中具有比较大的先发优势，其超高的性价比将会给客户提供更具竞争力的高速宽带无线通信的解决方案，该款芯片也是公司构建全系列短距无线通信解决方案的重要组成部分，是公司迈向高端无线局域网芯片供应商的奠基石。目前，公司已推出多款产品，部分产品已完成客户导入及量产，同时，公司积极开展 Wi-Fi7 芯片的预研工作。感谢您对公司的关注。

2、公司的边缘算力芯片是否可以拓展至更高算力？将在哪些新领域落地？

答：尊敬的投资者，您好。公司围绕“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算智能终端应用，解决传统 NPU 芯片大模型推理效率不足问题，公司创新提出 MLPU 芯片概念（面向多模态大模型的新型 AI 芯片架构），既能高效支持大模型推理计算，同时兼容传统小模型的高效推理。基于 MLPU 创新架构设计，公司形成了从 16TOPS 至 100TOPS 的智能终端 AI SoC 系列产品规划、低中高 AI SoC 布局并已投入研发，主要应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等边缘计算智能终端。

公司新一代 4K AI 视觉处理芯片 GK7606V1 系列搭载自研 AI ISP 引擎，内置双核 A55 处理器，拥有最高 2.5TOPS 算力，支持 4K 编解码、AI ISP、双 3D 降噪、图像防抖、多目拼接、多光谱融合等核心技术，具有高画质、低码率、低内存、低延时以及低功耗等优势，可用于智能安防、行车记录仪、无人机图传等领域，在客户端测试中表现抢眼，获得了国内主流安防企业与方案商的正向反馈。在实现 0.5T—8T 算力覆盖的基础上，公司积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力，全面拥抱

AI 时代。感谢您对公司的关注。

3、贵司 AI 芯片跟哪些车企有合作，研发进展如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司积极开拓及全面布局车载 AI 芯片和 SerDes 芯片领域市场，客户对象覆盖整车厂、Tier1 客户、方案公司等，以点线面的策略，全面覆盖整个汽车电子产业链。

公司当期可量产的车载 AI 芯片覆盖从 130 万到 800 万像素的摄像头，AI 算力覆盖 0.5TOPS 至 4TOPS，可灵活选择是否内置 DDR，并且已有多颗芯片通过了 AEC-Q100 Grade2 的测试认证，满足 ISO26262 ASIL B 功能安全要求。通过持续的算法、架构优化，当前 ISP 不仅可以支持 RGGB RAW 数据，还可以针对汽车座舱内应用，对 RGBIR 数据进行算法处理，满足 DMS/OMS 的需求。AI NPU 算力的提升可满足辅助驾驶、视觉感知的算力需求。目前，公司部分车载 AI 芯片与 SerDes 芯片已回片且完成测试，测试指标优秀，并已开始客户拓展并完成多个项目导入。同时，公司也在积极布局更高算力的车载 AI 芯片和更高传输速率的 SerDes 芯片。感谢您对公司的关注。

4、请问，国家大力发展具身智能，是否有助于提升公司产品销量、推动公司业绩发展？

答：尊敬的投资者，您好。随着 AI 技术的不断成熟以及应用场景的不断拓展，公司以构建“边缘 AI 芯引擎”为品牌战略，致力于将先进人工智能技术与大规模集成电路设计技术结合，为端侧人工智能落地提供更多优秀的 SoC 芯片及解决方案。

2024 年，公司围绕“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算智能终端应用，解决传统 NPU 芯片大模型推理效率不足问题，公司创新提出 MLPU 芯片概念（面向多模态大模型的新型 AI 芯片架构），既能高效支持大模型推理计算，同时兼容传统小模型的高效推理。基于 MLPU 创新架构设计，公司形成了从 16TOPS 至 100TOPS 的智能终端 AI SoC 系列产品规划，形成了低中高 AI SoC 布局并已投入研发，主要应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等边缘计算智能终端，预计 2026 年开始逐步量产上市。

公司将持续关注相关行业政策，积极把握市场机遇，具体业绩情况请您关注公司在指定信息披露媒体上披露的定期报告等相关公告。感谢您对公司的关注。

5、公司 2025 年业绩增长点有哪些？

答：尊敬的投资者，您好。公司在深耕主营业务的同时，积极拓展端侧人工智能、车载电子、无线局域网等业务领域。

超高清智能显示领域，公司将加快现有产品的推广，积极开发插入式机顶盒形态方案，并推动开放鸿蒙系统在商业显示、教育等领域的快速落地，满足商显客户对系统的所有需求。

智慧视觉领域，公司是目前市面少数在专业安防和消费类 IPC 产品双线布局的企业之一，2025 年度，公司 GK7606V1 系列、GK7203V1 系列、GK7206V1 系列、GK7205V1 系列产品的推出将会在客户层面形成从高到低产品覆盖，同时预计将在客户端取得更多的份额。

人工智能领域，公司紧跟大模型时代 AI 处理将呈现边云协同的多层次算力网络趋势，推进“边缘 AI 芯引擎”战略目标，在实现 0.5T—8T 算力覆盖的基础上，公司积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力，全面拥抱 AI 时代。

车载电子领域，公司当期可量产的车载 AI 芯片覆盖从 130 万到 800 万像素的摄像头，AI 算力覆盖 0.5TOPS 至 4TOPS，可灵活选择是否内置 DDR，并且已有多颗芯片通过了 AEC-Q100 Grade2 的测试认证；同时，公司将在 2025 年内推出多颗不同视频接口的 6.4Gbps 芯片，并形成大规模量产。通过车载 AI 芯片搭配 SerDes 芯片，可满足 CMS/DVR/DMS/OMS/环视等产品的需求，提供优画质、低延时、高性能、高性价比、完整的解决方案。

无线局域网领域，公司的 Wi-Fi6 2T2R 的无线局域网芯片开发完成并完成调试，正逐步开始客户导入，对拓展公司 Wi-Fi 产品的应用领域和市占率都具有重要的意义。公司加速研发进度，推出多款芯片，基本覆盖主流应用场景，并积极开展 Wi-Fi7 芯片的预研工作。感谢您对公司的关注。

6、车载 AI 芯片和 SerDes 芯片的客户导入进展如何？何时可以贡献规模化收入？

答：尊敬的投资者，您好。公司推出的车载 AI 系列芯片主要应用在前装智能摄像头、行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、摄像头监控系统、驾驶员疲劳监测系统、座舱监控系统、前视 ADAS 一体机等产品上。推出的 SerDes 芯片在前装车载业务领域，主要应用于智能座舱和智能驾驶的摄像头端和显示屏端的数据传输。

目前，公司已研发出车载 AI 芯片和高带宽、低时延的 SerDes 芯片，实现音视频 AI 处理和音视频流、控制信号的远距离传输。公司当期可量产的车载 AI 芯片覆盖从 130 万到 800 万像素的摄像头，AI 算力覆盖 0.5TOPS 至 4TOPS，可灵活选择是否内置 DDR，并且已有多颗芯片通过了 AEC-Q100 Grade2 的测试认证。公司研发的 SerDes 芯片支持的前向速率达到 6.4Gbps，系列化产品支持多种速率，反向速率 200Mbps，支持大于 15 米传输，处理插损超过 30dB，能根据信道情况进行自适应均衡，技术指标优秀，满足车载场景要求。

2024 年，公司部分车载 AI 芯片与 SerDes 芯片已回片且完成测试，测试指标优秀，并已开始客户拓展并完成多个项目导入。同时，公司积极开拓及全面布局车载 AI 芯片和 SerDes 芯片领域市场，客户对象覆盖整车厂、Tier1 客户、方案公司等，以点线面的策略，全面覆盖整个汽车电子产业链，全面开启车载市场开拓元年。感谢您对公司的关注。

7、2024 年利润分配预案为每 10 股派 3 元，分红比例 66.7%，未来分红政策是否延续？

答：尊敬的投资者，您好。2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计现金分红总额约 6,480 万元，占公司 2024 年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为 66.70%。公司高度重视股东回报，上市至今，公司累计现金分红总额超 3.5 亿元，占公司累计实现归母净利润的 41.91%。

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，公司根据相关法律法规及《公司章程》中关于现金分红

的规定，同时综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，后续，公司将制定合理的利润分配方案，持续实施现金分红回馈股东。感谢您对公司的关注。

8、超高清智能显示系列芯片产品的收入下降了 70%，请问未来计划如何提振？

答：尊敬的投资者，您好。2024 年，面对市场需求增长放缓、行业竞争加剧等不利因素，公司及时调整经营策略，缩减低毛利产品的销售以应对挑战。2024 年，超高清智能显示系列芯片产品实现销售收入 7.74 亿元，占总营收的 39.15%。营收虽同比有所下降，但产品毛利率同比增长 8 个百分点，展现出高质量发展的能力。

公司超高清智能显示芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT 机顶盒及 TV/商显领域。公司针对广电运营商市场和 IPTV 运营商市场推出的 GK63 系列目前均已大规模量产。在广电运营商领域，公司产品目前已在中国广电 90%以上的有线网络省分公司导入出货，进一步提升了公司 4K 产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在 IPTV 机顶盒领域，产品已经在中国电信、中国移动、中国联通等运营商侧实现批量出货，按照中标合同积极履行供货，在此过程中，公司积累了大量的各省软硬件适配和运营商招标落地工作经验，为深耕运营商市场打下了坚实基础。直播星 4K 智能机顶盒芯片及方案已经在零售市场批量出货，为 2025 年的大规模出货打下基础。同时，公司响应广播电视操作复杂治理需求，积极开发支持 GPMI 的 4K 解码芯片，有望 2025 年开始启动支持 GPMI 的插入式机顶盒的导入。

与此同时，公司推出的商显芯片 GK67 系列已在主流教育机、会议机及泛屏商显终端厂商出货，商显产品全面兼容鸿蒙生态，并通过鸿蒙 4.0 兼容认证，鸿蒙 5.0 正在开发迭代中。2024 年，依托鸿蒙生态优势，公司进一步扩大在上述领域的份额和出货，大客户维护稳定。目前，公司正在与各运营商和教育行业对接 AI 赋能产业升级需求。感谢您对公司的关注。

9、公司实施了哪些激励政策留住核心人才？

	答：尊敬的投资者，您好。为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高激励对象的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增长，2019 年至今，公司已成功实施完成两轮限制性股票激励计划，激励对象近 400 人，授予限制性股票数量近 500 万股。公司于 2025 年推出了新一轮限制性股票激励计划，拟向不超过 247 名激励对象授予 326.08 万股第二类限制性股票，相关事宜已由公司股东大会审议通过并实施。 同时，公司还实施了员工持股计划，参与员工的范围包括公司董事、监事、高级管理人员及骨干员工，持股计划的实施有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 未来，公司将继续做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是对产品研发人才进行科学管理，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，利用内外部资源，加大对人才开发的投入及自主培养的力度，建立人才梯队；完善人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的价值管理体系，运用人才的引进、培训开发、激励等方式方法，不断提升队伍的整体素质。感谢您对公司的关注。 10、公司在鸿蒙生态中的布局进展如何，鸿蒙生态布局有何重大意义？ 答：尊敬的投资者，您好。在鸿蒙生态领域，公司是目前为数不多的全系列产品均支持鸿蒙芯片及解决方案的供应商之一。2024 年，公司旗下共有 5 款产品通过鸿蒙 4.0 生态产品兼容性认证，全面拥抱国产生态。公司推出的商显芯片 GK67 系列已在主流教育机、会议机及泛屏商显终端厂商出货，商显产品全面兼容鸿蒙生态，并通过鸿蒙 4.0 兼容认证；鸿蒙 5.0 项目正在开发迭代中，预计 2025 年上半年产品开始导入。鸿蒙生态将是公司未来发力的重点方向之一。感谢您对公司的关注。 11、公司产品能应用到插入式微型机顶盒吗？ 答：尊敬的投资者，您好。相关资料介绍，超高清插入式微型机顶
--	---

	盒采用低功耗器件和紧凑化设计，体积较现网机顶盒降低 50%以上，可直接插在电视机 HDMI 接口上使用，实现了机顶盒小型化、隐藏化、减少连线的目标；支持 4K 超高清业务，符合超高清发展需求。搭配基于红外、蓝牙和星闪的三模通用遥控器，实现一个遥控器同时控制电视机和机顶盒，方便用户一键开关机、一键进直播。在超高清智能显示领域，公司持续加大投入，一方面加快现有产品的推广，在四大运营商中开发推广创新产品形态，结合编解码优势，将二者融合，以满足运营商对智慧家庭场景的需求；另一方面，为满足运营商电视操作复杂治理需求，公司将基于现有产品，积极开发插入式机顶盒形态方案，同时布局更适应插入式机顶盒方案的全国产芯片产品。公司积极开发支持 GPMI 的 4K 解码芯片，有望 2025 年开始启动支持 GPMI 的插入式机顶盒的导入。感谢您对公司的关注。 12、公司 2024 年毛利率为 26.29%，较上年提升了 13.85 个百分点，到 2025 年一季度整体毛利率达到 34.48%，出现这种变化的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年，面对市场需求增长放缓、行业竞争加剧等不利因素，公司坚持主业并积极发展新业务，不断开拓市场，抢占新赛道，并及时调整经营策略，缩减低毛利产品的销售以应对挑战。得益于产品结构调整，以及强化成本管控，公司在全年营收下降 53.26% 的情况下，公司毛利润保持在 5.2 亿元，同比基本保持不变，整体毛利率为 26.29%，同比提升 13.85 个百分点。2025 年一季度，公司进一步优化业务布局，研发与市场资源向高毛利、高门槛的业务进行配置，整体毛利率提升至 34.48%，同比提升 12 个百分点，为提升全年盈利能力奠定了良好开局，感谢您对公司的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 19 日